

SAP・MSAP用ファインパターン対応 ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤

Additives for Acid Copper Plating (SAP, MSAP) For Via-filling Applicable to Fine Pattern

トップルチナGAP

TOP LUCINA GAP

- パターンの幅や疎密にかかわらず、めっき膜厚の均一性に優れる

Regardless of pattern size/density, uniform thickness is available

- 大口径ビアホールのフィリングに対応

For filling large-diameter via-holes

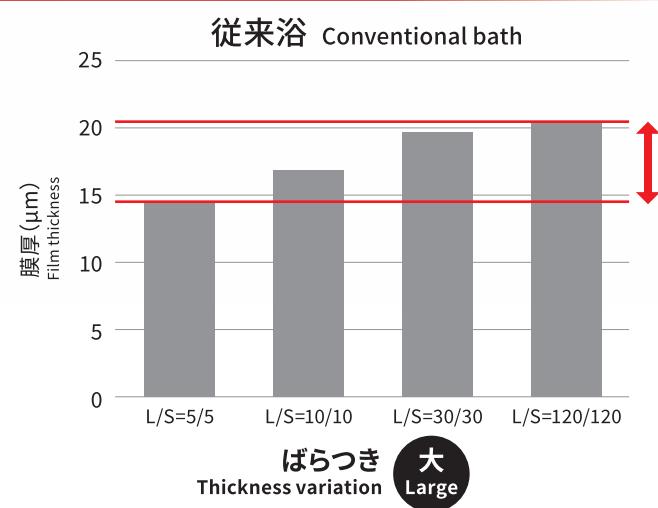
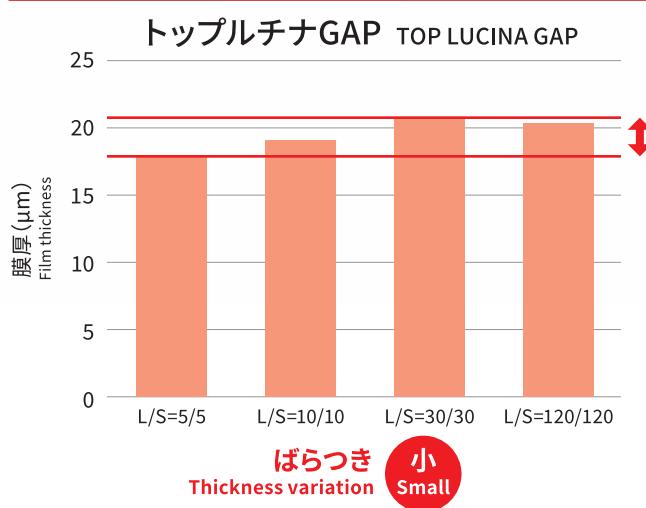
- 幅広い電流密度でビアフィリングが可能

Can make via-filling in wide current density areas

- 繊密で平滑な光沢外観が得られる

Fine, smooth, bright appearances can be obtained

配線幅間の膜厚のばらつきが小さい Small thickness variation between patterns



トップルチナGAPと従来浴の膜厚の比較(L/S=5/5)
Comparison of thickness between TOP LUCINA GAP and conventional product

様々なビア径に対して高いフィリング性を実現 High filling performance is available to various via-diameter

ビア径(μm) Hole diameter	膜厚(μm) Thickness	トップルチナGAP TOP LUCINA GAP	従来浴 Conventional bath
60	5	99%*	96%
80	7	95%	77%
110	12	91%	49%

*ビアフィリング率
*Via-filling ratio

幅広い電流密度に対応 Applicable to wide current density

